

## 第 21 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 30 年 5 月 14 日(月) 10:30~16:30

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室 (東京都中央区)

時間	題 目	講 演 者
	司会 佐名川 佳治 (パナソニック(株))	
10:30~ 11:50	『UVナノインプリント法を用いた 集光ミラー付きポリマー光導波路の開発』 (40分)	○鈴木 健太、天野 建、乗木 暁博 (産業技術総合研究所)
	『超音波照射法による鉛フリーはんだ微粒子 形成』 (40分)	○古澤 彰男、日根 清裕(パナソニック (株))、岸 新、吉岡 祐樹(パナソニック スマートファクトリーソリューションズ (株))、林 大和、滝澤 博胤(東北大学)
11:50~ 12:50	昼 食 休 憩	
12:50~ 13:00	委 員 会 議 事	
	司会 和田 剛優 ((株)弘輝)	
13:00~ 14:20	『極小SMD(0201~03015)実装のポイント』 (40分)	○川井 建三(ヤマハ発動機(株))
	『真空リフロー炉を用いた実装品質の向上』 (40分)	○川野 佑介(千住金属工業(株))
14:20~ 14:30	休 憩	
	司会 松岡 洋 (日本電気(株))	
14:30~ 16:30	『無洗浄を可能とするギ酸リフロー対応 AuSn ペーストに関する研究』 (40分)	○八十嶋 司、片瀬 琢磨、石川 雅之 (三菱マテリアル(株))
	『無電解Ni/Pd/Auのはんだ種類の違いに おけるはんだ接合強度と合金層の解析』 (40分)	○小田 幸典(上村工業((株))
	『無電解 Ni-P/置換 Cu めっきが高温環境下 のはんだ接合性に及ぼす影響』 (40分)	○大矢 怜史、中木原早紀 ((株)クオルテック)

( )内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。